

Dell EMC PowerEdge C6520

기술 사양

참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

장 1: 기술 사양	4
슬레드 크기.....	4
새시 중량.....	5
프로세서 사양.....	5
PSU 사양.....	5
지원되는 운영 체제.....	5
시스템 배터리 사양.....	6
확장 카드 라이저 사양.....	6
메모리 사양.....	6
드라이브.....	6
스토리지 사양.....	7
포트 및 커넥터 사양.....	8
USB 포트 사양.....	8
디스플레이 포트 사양.....	8
NIC 포트 사양.....	8
iDRAC9 포트 사양.....	8
비디오 사양.....	8
환경 사양.....	8
미세 먼지 및 가스 오염 사양.....	9
열 제한 사항.....	10

기술 사양

이 섹션에는 시스템의 기술 및 환경 사양이 설명되어 있습니다.

주제:

- 슬레드 크기
- 새시 중량
- 프로세서 사양
- PSU 사양
- 지원되는 운영 체제
- 시스템 배터리 사양
- 확장 카드 라이저 사양
- 메모리 사양
- 드라이브
- 스토리지 사양
- 포트 및 커넥터 사양
- 비디오 사양
- 환경 사양

슬레드 크기

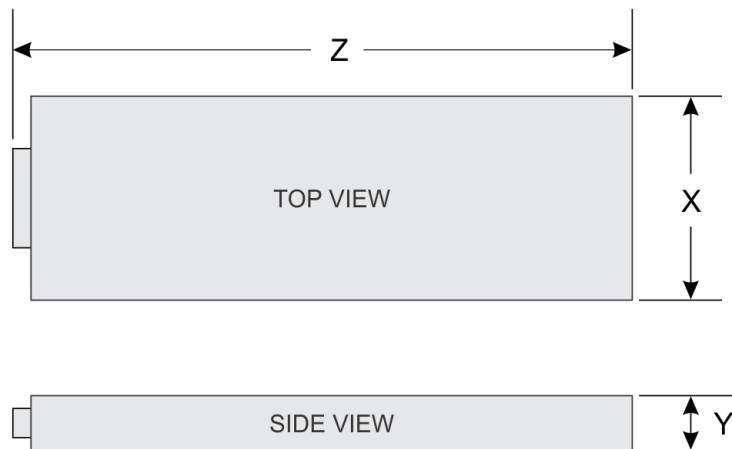


그림 1. 슬레드 크기

표 1. PowerEdge C6520 슬레드 크기

X	Y	Z
447.04mm(17.6")	86.36mm(3.4")	802.64mm(31.6")

새시 중량

표 2. PowerEdge C6520 슬레드가 있는 엔클로저의 새시 중량

시스템 구성	최대 중량(모든 슬레드 및 드라이브 포함)
12개의 3.5인치	45.6kg(100.53lb)
24개의 2.5"	41.4kg(91.27lb)
백플레인 없는 시스템	35kg(77.16lb)

프로세서 사양

표 3. PowerEdge C6520 프로세서 사양

지원되는 프로세서	지원되는 프로세서의 수
3세대 인텔 제온 확장 가능 프로세서 최대 40코어	2개

PSU 사양

PowerEdge C6520 시스템은 최대 2개의 AC PSU(Power Supply Unit)를 지원합니다.

표 4. PSU 사양

PSU	등급	열 손실(최대)	주파수	전압	AC		전류
					하이 라인	낮은 라인 100~120V	
2600W	플래티넘 플래티넘	9750BTU/hr	50/60Hz	100~240V 자동 범위 조정	2600W(220~240V)	1400W	16 A
2400W	플래티넘	9000BTU/hr	50/60Hz	100~240V 자동 범위 조정	2400W(200~240V)	1400W	16 A
2000W	플래티넘	7500 BTU/hr	50/60Hz	100~240V 자동 범위 조정	2000W(200~240V)	1000 W	11.5A
1600W	플래티넘	6000 BTU/hr	50/60Hz	100~240V 자동 범위 조정	1600W(200~240V)	800 W	10 A

① **노트:** 부품 번호 9D4R6이 있는 2600W PSU는 C14-C19 어댑터 코드만 지원합니다.

① **노트:** 또한 이 시스템은 상간 전압 240V를 초과하지 않는 IT 전원 시스템에 연결하도록 설계되어 있습니다.

① **노트:** 열 손실은 PSU 와트 정격을 사용하여 계산합니다.

① **노트:** 시스템 구성 선택 또는 업그레이드 시 최적 전원 활용도를 보장하려면 Dell.com/ESSA에서 Dell Energy Smart Solution Advisor를 사용하여 시스템 에너지 소비를 확인하십시오.

지원되는 운영 체제

PowerEdge C6520 시스템은 다음 운영 체제를 지원합니다.

- Ubuntu Canonical - Ubuntu Server LTS
- Citrix 하이퍼바이저
- Microsoft Windows Server(Hyper-V 포함)
- Red Hat Enterprise Linux

- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi/vSAN
- CentOS
- WinPE(Windows Preinstallation Environment) 64비트 드라이버

자세한 내용은 www.dell.com/ossupport 섹션을 참조하십시오.

시스템 배터리 사양

PowerEdge C6520 시스템은 CR 2032 3.0-V 리튬 코인 셀 시스템 배터리를 지원합니다.

확장 카드 라이저 사양

PowerEdge C6520 시스템은 최대 4개의 PCIe(PCI express) Gen 4 확장 카드를 지원합니다.

표 5. 시스템 보드에서 지원되는 확장 카드 슬롯

PCIe 슬롯	라이저	라이저 너비	PCIe 슬롯 높이	PCIe 슬롯 길이	PCIe 슬롯 너비
슬롯 1	라이저 1a	x16 PCIe	로우 프로파일	HL(Half Length)	x8
슬롯 1	라이저 1bSNAP I/O 모듈을 지원하는 라이저 1b	x16 PCIe	로우 프로파일	HL(Half Length)	x8 + x8
슬롯 2	라이저 2b	x16 PCIe	로우 프로파일	HL(Half Length)	x8

이 노트: 확장 카드 설치 지침에 대한 자세한 내용은 시스템별 *설치 및 서비스 매뉴얼* 참조 링크: <https://www.dell.com/poweredgemanuals> 섹션을 참조하십시오.

메모리 사양

PowerEdge C6520 시스템은 최적화된 운영을 위해 다음과 같은 메모리 사양을 지원합니다.

표 6. 메모리 사양

DIMM 유형	DIMM 랭크	DIMM 용량	단일 프로세서		듀얼 프로세서	
			최소 시스템 용량	최대 시스템 용량	최소 시스템 용량	최대 시스템 용량
RDIMM	싱글 랭크	8GB	8GB	64GB	16GB	128GB
	듀얼 랭크	16GB	16GB	128GB	32GB	256GB
		32GB	32GB	256GB	64GB	512GB
		64GB	64GB	512GB	128GB	1TB
LRDIMM	쿼드 랭크	64GB	64GB	512GB	128GB	1TB
		128GB	128GB	1TB	256GB	2TB

표 7. 메모리 모듈 소켓

메모리 모듈 소켓	속도
16개, 288핀	3200MT/s, 2933MT/s, 2666MT/s

드라이브

PowerEdge C6520 시스템은 다음을 지원합니다.

- 12개의 3.5인치 SAS/SATA(HDD/SSD) 드라이브

- 24개의 2.5" SAS/SATA(HDD/SSD) /NVMe 드라이브.

표 8. PowerEdge C6520 슬레드에 지원되는 최대 드라이브 수 옵션

슬레드 내부 드라이브의 최대 개수	슬레드당 할당된 드라이브의 최대 개수
12개의 3.5인치 드라이브 시스템	슬레드당 3개의 SAS 또는 SATA 드라이브 및 SATA SSD
24개의 2.5" 비NVMe 드라이브 구성	슬레드당 6개의 SAS 또는 SATA 드라이브 및 SATA SSD
8개의 2.5" NVMe 드라이브 구성(슬레드당 2개의 NVMe 드라이브/새시당 8개의 NVMe 드라이브)	NVMe 백플레인에는 다음 구성 중 하나를 지원합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 슬레드당 2개의 NVMe 드라이브 및 4개의 SAS 또는 SATA 드라이브와 SATA SSD ① 노트: NVMe 드라이브는 PCIe Gen3 속도로 제한됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 슬레드당 6개의 SAS 또는 SATA 드라이브 및 SATA SSD
24개의 2.5" NVMe 드라이브 구성	슬레드당 6개의 NVMe 드라이브
M.2 SATA 드라이브(옵션)	M.2 SATA 카드의 지원 용량은 최대 960GB입니다. ① 노트: M.2 SATA 카드는 M.2 라이저 또는 BOSS 카드에 설치될 수 있습니다.
부팅용 Micro-SD 카드(옵션, 최대 64GB)	라이저 1a에 1개

①|노트: NVMe PCIe SSD U.2 디바이스 핫 스왑 방법에 대한 자세한 정보는 <https://www.dell.com/support> 모든 제품 검색 > 데이터 센터 인프라스트럭처 > 스토리지 어댑터 및 컨트롤러 > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD > 문서 자료 > 매뉴얼 및 문서에서 *Dell Express Flash NVMe PCIe SSD 사용자 가이드*를 참조하십시오.

스토리지 사양

PowerEdge C6520 슬레드는 다음을 지원합니다.

표 9. 시스템의 스토리지 컨트롤러 카드

내부 컨트롤러	외부 컨트롤러
<ul style="list-style-type: none"> • PERC H745 • HBA355i • HBA345 • S150 • H345 • BOSS-S1(Boot Optimized Storage Subsystem): HWRAID 2개의 M.2 SSD • H350 • H750 	<ul style="list-style-type: none"> • 12Gbps SAS(외부) HBA

표 10. M.2 SATA 드라이브와 함께 지원되는 RAID 옵션

옵션	RAID가 없는 단일 M.2 SATA 드라이브	하드웨어 RAID가 있는 이중 M.2 SATA 드라이브
하드웨어 RAID	아니요	예
RAID 모드	해당 없음	RAID 1, RAID 0
지원되는 드라이브 수	1	2
지원되는 CPU	CPU 1	CPU 1

①|노트: RAID 옵션은 2개의 M.2 SATA 드라이브를 지원하는 BOSS 카드에서만 지원됩니다.

포트 및 커넥터 사양

USB 포트 사양

PowerEdge C6520 슬레드는 시스템 후면에서 USB 3.0를 지원합니다.

디스플레이 포트 사양

PowerEdge C6520 슬레드는 1개의 미니 DisplayPort 를 지원합니다.

NIC 포트 사양

PowerEdge C6520 슬레드는 LOM(LAN on Motherboard)에 내장되고 OCP(Open Compute Project) 카드(옵션)에 통합된 1개의 10/100/1000Mbps NIC(Network Interface Controller) 포트를 지원합니다.

표 11. 슬레드의 NIC 포트 사양

기능	사양
LOM 카드	1GbE
OCP 3.0 카드	4개의 1GbE, 2개의 10GbE, 2개의 25GbE, 4개의 25GbE

iDRAC9 포트 사양

PowerEdge C6520 슬레드는 시스템 후면에 있는 1개의 iDRAC Direct 포트(Micro-AB USB)를 지원합니다.

비디오 사양

PowerEdge C6520 시스템은 16MB의 비디오 프레임 버퍼를 사용하는 내장형 Matrox G200 그래픽 컨트롤러를 지원합니다.

표 12. 시스템에 지원되는 전면 비디오 해상도 옵션

해상도	화면 재생률(hz)	색 심도(비트)
1024 x 768	60	8, 16, 32
1280 x 800	60	8, 16, 32
1280 x 1024	60	8, 16, 32
1360 x 768	60	8, 16, 32
1440 x 900	60	8, 16, 32
1600 x 900	60	8, 16, 32
1600 x 1200	60	8, 16, 32
1680 x 1050	60	8, 16, 32
1920 x 1080	60	8, 16, 32
1920 x 1200	60	8, 16, 32

환경 사양

 **노트:** 환경 인증에 대한 추가 정보는 www.dell.com/support/home에서 문서의 **제품 환경 데이터 시트**를 참조하십시오.

표 13. 운영 기후 범위 범주 A3

온도	사양
허용할 수 있는 연속 운영	
고도 900m 이하(2,953ft 이하)의 온도 범위	장비가 직사광선을 받지 않는 상태에서 5~40°C(41~104°F)
습도 백분율 범위(항상 비응축)	-12°C 최소 이슬점의 8% RH~24°C(75.2°F) 최대 이슬점의 85% RH
운영 고도 디레이팅	최대 온도는 900m(2,953ft) 초과 시 1°C/175m(33.8°F/574ft)만큼 감소합니다.

표 14. 모든 범주 간 공유된 요구 사항

온도	사양
허용할 수 있는 연속 운영	
최대 온도 변화(운영 및 비운영 모두에 적용)	1시간 내 20°C*(1시간 내 36°F) 및 15분 내 5°C(15분 내 41°F), 테이프의 경우 1시간 내 5°C*(1시간 내 41°F) 이 노트: *: 테이프 하드웨어에 대한 ASHRAE 열 지침에 따르면 이는 온도의 순간 변화율이 아닙니다.
비운영 온도 제한	-40~65°C(-104~149°F)
비운영 습도 제한	5%~95% RH, 최대 이슬점 27°C(80.6°F)
최대 비운영 고도	12,000m(39,370ft)
최대 운영 고도	3,048m(10,000ft)

최대 진동 사양

표 15. 최대 진동 사양

최대 진동	사양
작동 시	5Hz~350Hz에서 0.26Grms(모든 작동 방향)
스토리지	10Hz~500Hz에서 15분 간 1.88Grms(6개 측면 모두 테스트)

최대 충격 펄스 사양

표 16. 최대 충격 사양

최대 충격	사양
작동 시	최대 11ms 동안 양수/음수 x, y, z축으로 6G의 연속 충격 펄스 6회(시스템 각 측면에 4회의 펄스).
스토리지	최대 2ms 동안 x, y, z축으로 ±71G의 연속 충격 펄스 6회(시스템 각 측면에 1회의 펄스)

미세 먼지 및 가스 오염 사양

다음 표는 미세 먼지 및 기체 오염으로 인한 IT 장비 손상 및/또는 장애를 방지하는 데 도움이 되는 제한 사항을 정의합니다. 미세 먼지 또는 기체 오염 수준이 지정된 제한 사항을 초과하여 그 결과로 장비 손상 또는 장애가 발생하는 경우 환경 조건을 바로잡아야 합니다. 환경을 개선하는 것은 고객의 책임입니다.

표 17. 미세 먼지 오염 사양

미세 먼지 오염	사양
공기 여과	데이터 센터 공기 여과는 ISO Class 8 per ISO 14644-1의 규정에 따라 95% 상위 지수 제한됩니다.

표 17. 미세 먼지 오염 사양 (계속)

미세 먼지 오염	사양
	<p>i 노트: 이 조건은 데이터 센터 환경에만 적용됩니다. 공기 여과 요구사항은 사무실이나 공장 바닥과 같은 환경인 데이터 센터 외 공간에서의 IT 장비에는 적용되지 않습니다.</p> <p>i 노트: 데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV11 또는 MERV13 여과여야 합니다.</p>
전도성 먼지	<p>공기에는 전도성 먼지, 아연 휘스커, 또는 기타 전도성 입자가 없어야 합니다.</p> <p>i 노트: 이 조건은 데이터 센터 및 데이터 센터 외부 환경에 적용됩니다.</p>
부식성 먼지	<ul style="list-style-type: none"> 공기에는 부식성 먼지가 없어야 합니다. 공기 내 잔여 먼지는 용해점이 60% 상대 습도 미만이어야 합니다. <p>i 노트: 이 조건은 데이터 센터 및 데이터 센터 외부 환경에 적용됩니다.</p>

표 18. 기체 오염 사양

기체 오염	사양
구리 쿠폰 부식률	ANSI/ISA71.04-2013의 규정에 따라 Class G1당 300Å/월 미만
은 쿠폰 부식률	ANSI/ISA71.04-2013의 규정에 따라 200Å/월 미만

i **노트:** ≤50% 상대 습도에서 측정된 최대 부식성 오염 수치

열 제한 사항

i **노트:**

- 제공되지 않음: Dell EMC에서 제공되지 않는 구성을 나타냅니다.
- 지원되지 않음: 열적으로 지원되지 않는 구성을 나타냅니다.

i **노트:** 주위 온도가 이 표에 나열된 최대 연속 운영 온도 이하인 경우 충분한 열 마진으로 DIMM, 통신 카드, M.2 SATA 및 PERC 카드를 포함한 모든 구성 요소를 지원할 수 있습니다.

i **노트:** 일부 시스템 하드웨어 구성에는 더 낮은 상한 온도 제한이 필요합니다. 운영 온도 요구 사항에 대한 자세한 정보는 기술 지원에 문의하십시오.

i **노트:** 일부 구성에는 보다 낮은 주위 온도가 필요합니다. 자세한 정보는 다음 표를 참조하십시오.

다음 표에는 시스템에 구성된 CPU를 기준으로 주위 온도에 대한 주요 제한 사항이 나와 있습니다. 아래에 나와 있는 모든 유입 온도는 연속 섭씨 온도입니다.

표 19. 2.5" 직접/2.5" NVMe 드라이브 구성(공랭)을 사용하는 듀얼 프로세서의 최대 연속 운영 온도

프로세서	TDP(W)	코어	6개의 드라이브/슬레드	4개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드	BP 없음
8380	270	40	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8368	270	38	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8368Q	270	38	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8362	265	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8360Y	250	36	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음

표 19. 2.5" 직접/2.5" NVMe 드라이브 구성(공랭)을 사용하는 듀얼 프로세서의 최대 연속 운영 온도 (계속)

프로세서	TDP(W)	코어	6개의 드라이브/슬레드	4개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드	BP 없음
8358	250	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8358P	240	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20
6348	235	28	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20
6342	230	24	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20
8352Y	205	32	20	20	25	25	25
8352S	205	32	20	20	25	25	25
6338	205	32	20	20	25	25	25
6330	205	28	20	20	25	25	25
6354	205	18	지원되지 않음	20	20	20	25
6346	205	16	지원되지 않음	20	20	20	25
8352V	195	36	20	20	25	25	25
8352M	185	32	20*	20*	25	25	25
6338N	185	32	20*	20*	25	25	25
5320	185	26	20*	20*	25	25	25
6336Y	185	24	20*	20*	25	25	25
6326	185	16	20*	20*	25	25	25
6330N	165	28	25	25*	25*	25*	25*
6338T	165	24	25	25*	25*	25*	25*
5318Y	165	24	25	25*	25*	25*	25*
5318S	165	24	25	25*	25*	25*	25*
6334	165	8	25	25*	25*	25*	25*
5318N	150	24	25*	30	30	30	30*
5320T	150	20	25*	30	30	30	30*
4316	150	20	25*	30	30	30	30*
5317	150	12	25*	30	30	30	30*
5315Y	140	8	30	30	30*	30*	30*
4314	135	16	30*	30*	30*	30*	30*
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

이 노트:

- * 표시가 있는 데이터는 이 구성에서 HSK를 포함하는 확장 프로세서 1을 사용하는 경우 온도 오프셋이 +5°C일 수 있음을 의미합니다.
- H745는 프로세서 TDP가 185W를 초과하면 지원되지 않습니다.
- 25W를 초과하는 PCIE, 128GB LRDIMM 및 GPU 구성에는 추가적인 열 제한 사항이 필요합니다.

표 20. 프로세서 1에 대해 2.5" 직접 드라이브 구성(공랭)을 사용하는 단일 프로세서의 최대 연속 운영 온도

프로세서	TDP(W)	코어	6개의 드라이브/슬레드	4개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드	BP 없음
8380	270	40	20	20	20	20	25
8368	270	38	20	20	25	25	25
8368Q	270	38	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8362	265	32	20	20	25	25	25
8360Y	250	36	20	20	25	25	25
8358	250	32	20	20	25	25	25
8358P	240	32	20	20	25	25	25
6348	235	28	25	25	25	25	30
6342	230	24	25	25	25	25	30
8351N	225	36	20	20	25	25	25
8352Y	205	32	30	30	35	35	35
6314U	205	32	30	30	35	35	35
8352S	205	32	30	30	35	35	35
6338	205	32	30	30	35	35	35
6330	205	28	30	30	35	35	35
6354	205	18	25	25	30	30	30
6346	205	16	25	25	30	30	30
8352V	195	36	30	30	30	30	35
8352M	185	32	35	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35	35
6312U	185	24	35	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35	35

표 20. 프로세서 1에 대해 2.5" 직접 드라이브 구성(공랭)을 사용하는 단일 프로세서의 최대 연속 운영 온도 (계속)

프로세서	TDP(W)	코어	6개의 드라이브/슬레드	4개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드	BP 없음
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

이 | **노트:** 25W를 초과하는 PCIE, 128GB LRDIMM 및 GPU 구성에는 추가적인 열 제한 사항이 필요합니다.

표 21. 2.5" NVMe 드라이브 구성(공랭)을 사용하는 듀얼 프로세서의 최대 연속 운영 온도

프로세서	TDP(W)	코어	6개의 드라이브/슬레드	4개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드
8380	270	40	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8368	270	38	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8368Q	270	38	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8362	265	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8360Y	250	36	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8358	250	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8358P	240	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6348	235	28	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6342	230	24	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20
8352Y	205	32	20	20	25	25
8352S	205	32	20	20	25	25
6338	205	32	20	20	25	25
6330	205	28	20	20	25	25
6354	205	18	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20
6346	205	16	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20
8352V	195	36	20	20	25	25
8352M	185	32	20	20	25	25
6338N	185	32	20	20	25	25
5320	185	26	20	20	25	25
6336Y	185	24	20	20	25	25
6326	185	16	20	20	25	25
6330N	165	28	20*	20*	25*	25*
6338T	165	24	20*	20*	25*	25*
5318Y	165	24	20*	20*	25*	25*
5318S	165	24	20*	20*	25*	25*
6334	165	8	20*	20*	25*	25*
5318N	150	24	25	25	30	30
5320T	150	20	25	25	30	30
4316	150	20	25	25	30	30
5317	150	12	25	25	30	30

표 21. 2.5" NVMe 드라이브 구성(공랭)을 사용하는 듀얼 프로세서의 최대 연속 운영 온도 (계속)

프로세서	TDP(W)	코어	6개의 드라이브/슬레드	4개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드
5315Y	140	8	25*	25*	30*	30*
4314	135	16	25*	25*	30*	30*
4310	120	12	30	30	35	35
4310T	105	10	30*	30*	35	35
4309Y	105	8	30*	30*	35	35

표 22. 3.5" 직접 드라이브 구성(공랭)을 사용하는 듀얼 프로세서의 최대 연속 운영 온도

프로세서	TDP(W)	코어	3개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드
8380	270	40	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8368	270	38	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8368Q	270	38	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8362	265	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8360Y	250	36	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8358	250	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8358P	240	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6348	235	28	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6342	230	24	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8351N	225	36	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8352Y	205	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6314U	205	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8352S	205	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6338	205	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6330	205	28	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6354	205	18	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6346	205	16	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8352V	195	36	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8352M	185	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6338N	185	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
5320	185	26	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6336Y	185	24	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6312U	185	24	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6326	185	16	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
6330N	165	28	지원되지 않음	지원되지 않음	20
6338T	165	24	지원되지 않음	지원되지 않음	20
5318Y	165	24	지원되지 않음	지원되지 않음	20
5318S	165	24	지원되지 않음	지원되지 않음	20
6334	165	8	지원되지 않음	지원되지 않음	20

표 22. 3.5" 직접 드라이브 구성(공랭)을 사용하는 듀얼 프로세서의 최대 연속 운영 온도 (계속)

프로세서	TDP(W)	코어	3개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드
5318N	150	24	지원되지 않음	지원되지 않음	20
5320T	150	20	지원되지 않음	지원되지 않음	20
4316	150	20	지원되지 않음	지원되지 않음	20
5317	150	12	지원되지 않음	지원되지 않음	20
5315Y	140	8	지원되지 않음	20	20*
4314	135	16	지원되지 않음	20*	20*
4310	120	12	20	25	25
4310T	105	10	25	30	30
4309Y	105	8	25	30	30

표 23. 3.5" 직접 드라이브 구성(공랭)을 사용하는 단일 프로세서의 최대 연속 운영 온도

프로세서	TDP(W)	코어	3개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드
8380	270	40	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8368	270	38	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8368Q	270	38	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8362	265	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8360Y	250	36	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8358	250	32	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
8358P	240	32	지원되지 않음	지원되지 않음	20
6348	235	28	지원되지 않음	20	20
6342	230	24	지원되지 않음	20	20
8351N	225	36	지원되지 않음	지원되지 않음	20
8352Y	205	32	20	25	25
6314U	205	32	20	25	25
8352S	205	32	20	25	25
6338	205	32	20	25	25
6330	205	28	20	25	25
6354	205	18	지원되지 않음	20	25
6346	205	16	지원되지 않음	20	25
8352V	195	36	20	25	25
8352M	185	32	25	30	30
6338N	185	32	25	30	30
5320	185	26	25	30	30
6336Y	185	24	25	30	30
6312U	185	24	25	30	30
6326	185	16	25	30	30
6330N	165	28	25	30	30

표 23. 3.5" 직접 드라이브 구성(공랭)을 사용하는 단일 프로세서의 최대 연속 운영 온도 (계속)

프로세서	TDP(W)	코어	3개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드
6338T	165	24	25	30	30
5318Y	165	24	25	30	30
5318S	165	24	25	30	30
6334	165	8	25	30	30
5318N	150	24	30	35	35
5320T	150	20	30	35	35
4316	150	20	30	35	35
5317	150	12	30	35	35
5315Y	140	8	30	35	35
4314	135	16	30	35	35
4310	120	12	30	35	35
4310T	105	10	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35

표 24. 2.5" 직접/2.5" NVMe 드라이브 구성(수랭)을 사용하는 듀얼 프로세서의 최대 연속 운영 온도

프로세서	TDP(W)	코어	6개의 드라이브/슬레드	4개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드	BP 없음
8380	270	40	35	35	35	35	35
8368	270	38	35	35	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35	35	35
8362	265	32	35	35	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35	35	35
8358	250	32	35	35	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35	35	35
6348	235	28	35	35	35	35	35
6342	230	24	35	35	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35	35	35
6338	205	32	35	35	35	35	35
6330	205	28	35	35	35	35	35
6354	205	18	35	35	35	35	35
6346	205	16	35	35	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35	35

표 24. 2.5" 직접/2.5" NVMe 드라이브 구성(수랭)을 사용하는 듀얼 프로세서의 최대 연속 운영 온도 (계속)

프로세서	TDP(W)	코어	6개의 드라이브/슬레드	4개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드	BP 없음
6330N	165	28	35	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

이 | **노트:** 25W를 초과하는 PCIE, 128GB LRDIMM 및 GPU 구성에는 추가적인 열 제한 사항이 필요합니다.

표 25. 2.5" NVMe 드라이브 구성(수랭)을 사용하는 듀얼 프로세서의 최대 연속 운영 온도

프로세서	TDP(W)	코어	6개의 드라이브/슬레드	4개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드
8380	270	40	35	35	35	35
8368	270	38	35	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35	35
8362	265	32	35	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35	35
8358	250	32	35	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35	35
6348	235	28	35	35	35	35
6342	230	24	35	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35	35
6338	205	32	35	35	35	35
6330	205	28	35	35	35	35
6354	205	18	35	35	35	35
6346	205	16	35	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35

표 25. 2.5" NVMe 드라이브 구성(수랭)을 사용하는 듀얼 프로세서의 최대 연속 운영 온도 (계속)

프로세서	TDP(W)	코어	6개의 드라이브/슬레드	4개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드
5320	185	26	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35

이 노트: 25W를 초과하는 PCIe, 128GB LRDIMM 및 GPU 구성에는 추가적인 열 제한 사항이 필요합니다.

표 26. 3.5" 직접 드라이브 구성(수랭)을 사용하는 듀얼 프로세서의 최대 연속 운영 온도

프로세서	TDP(W)	코어	3개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드
8380	270	40	35	35	35
8368	270	38	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35
8362	265	32	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35
8358	250	32	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35
6348	235	28	35	35	35
6342	230	24	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35
6338	205	32	35	35	35
6330	205	28	35	35	35
6354	205	18	35	35	35
6346	205	16	35	35	35

표 26. 3.5" 직접 드라이브 구성(수랭)을 사용하는 듀얼 프로세서의 최대 연속 운영 온도 (계속)

프로세서	TDP(W)	코어	3개의 드라이브/슬레드	2개의 드라이브/슬레드	1개의 드라이브/슬레드
8352V	195	36	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35
5320	185	26	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35
6326	185	16	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35
6334	165	8	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35
4316	150	20	35	35	35
5317	150	12	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35
4314	135	16	35	35	35
4310	120	12	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35

이 노트: 25W를 초과하는 PCIe, 128GB LRDIMM 및 GPU 구성에는 추가적인 열 제한 사항이 필요합니다.

ASHRAE A3 구성 제한 사항

표 27. ASHRAE A3 구성 제한 사항

수랭식	공랭식
<ul style="list-style-type: none"> • NVMe SSD는 지원되지 않습니다. • LRDIMM은 지원되지 않습니다. • 25W를 초과하는 PCIe 카드는 지원되지 않습니다. • GPU 카드는 지원되지 않습니다. • 3.5" 드라이브 구성은 지원되지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • NVMe SSD는 지원되지 않습니다. • LRDIMM은 지원되지 않습니다. • 25W를 초과하는 PCIe 카드는 지원되지 않습니다. • GPU 카드는 지원되지 않습니다. • 3.5" 드라이브 구성은 지원되지 않습니다. • 1P 슬레드의 경우 지원되는 최대 CPU TDP는 150W입니다. • 2P 슬레드의 경우 지원되는 최대 CPU TDP는 105W입니다.